

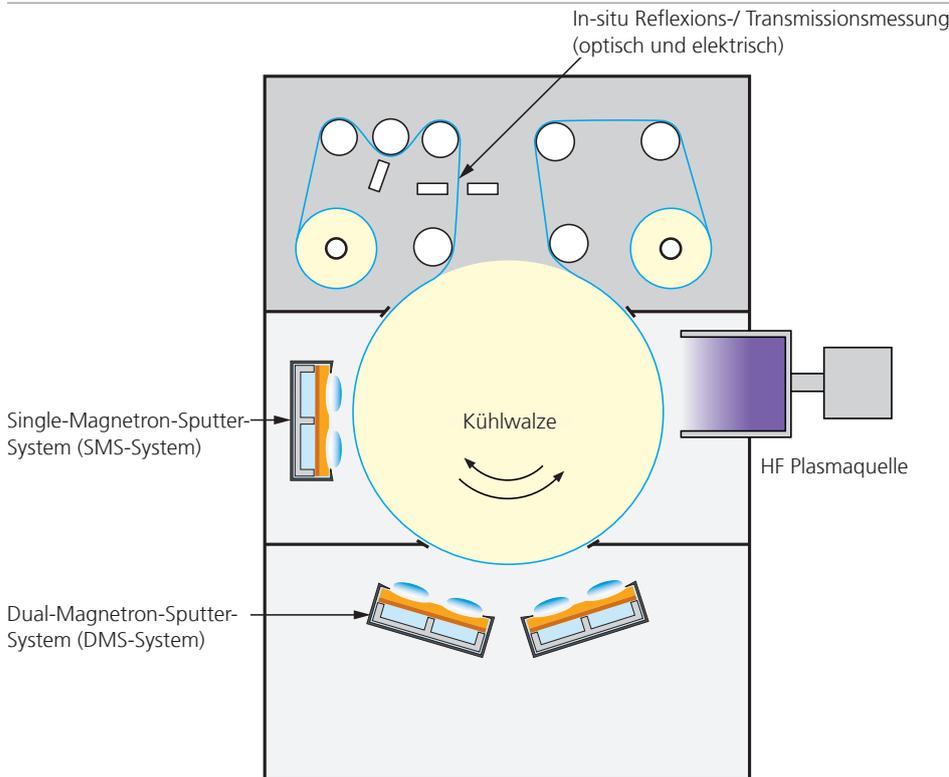
labFlex[®] 200

Laborsputteranlage

Technische Daten

Beschichtungsbreite	200 mm
Banddicke	12 ... 200 µm
Bandgeschwindigkeit	0,1 ... 6 m/min
Prozessmodule	<ul style="list-style-type: none">• Dual-Magnetron-Sputter-System (DMS-System)• Single-Magnetron-Sputter-System (SMS-System)• Ionenquelle• HF Plasmaquelle
Beschichtungskammern	3
Beschichtungsmaterial	Metalle, TiO ₂ , SiO ₂ , Nb ₂ O ₅ , ITO, ZAO, SnO ₂ , HfO ₂ , WO ₃ , TiN, Si ₃ N ₄ , ZrO ₂
In-situ-Messung	<ul style="list-style-type: none">• optische Transmission + Reflexion• elektrischer Widerstand

Schema der Anlage



Technologie

Puls-Magnetron-Sputtern

- Dual-Magnetron-Sputtern
- Magnetron-PECVD
- In-line Vorbehandlung
- Gesamttechnologie für die Herstellung von Schichtsystemen unter produktionsnahen Bedingungen
- Plasmapolymersation
- DC-Sputtern

Geschäftsfeld

Beschichtung von flexiblen Produkten

Die Oberflächenveredelung von Kunststofffolien und anderen flexiblen Substraten mit dünnen Schichten ermöglicht den Einsatz dieser Materialien in einer Vielzahl von innovativen Produkten.

Als effizientes und kostengünstiges Verfahren wird im Fraunhofer FEP die Vakuumbeschichtung in Rolle-zu-Rolle-Anlagen genutzt. Grundlegende Untersuchungen zu den verwendeten Technologien werden darüber hinaus an separaten Batchanlagen durchgeführt.

Fraunhofer-Institut für Elektronenstrahl- und Plasmatechnik FEP

Winterbergstraße 28
01277 Dresden, Deutschland

www.fep.fraunhofer.de
info@fep.fraunhofer.de

Dr. Matthias Fahland
matthias.fahland@fep.fraunhofer.de

Telefon +49 351 2586-135
Fax +49 351 258655-135

Dr. Nicolas Schiller
nicolas.schiller@fep.fraunhofer.de

Telefon +49 351 2586-131
Fax +49 351 258655-131